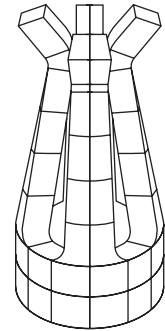
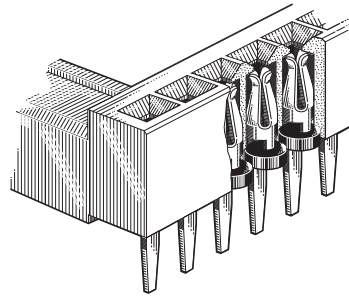
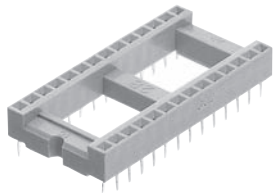


4面接触方式チュールリップ型ミューコンタクトにより、高信頼性・経済性を両立。

■コンタクト構造

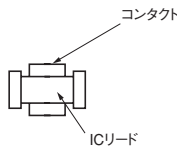


すべてのコンタクトがICリードと面接触する方向に整列したチュールリップ型ミューコンタクト

ABAQUSを用いた、コンタクト設計

■特長

1. ピッタリ4面接触で長寿命。



(上面から見た図)

ICリードとピッタリ面接触するため、接触面の磨耗が少なく長挿抜寿命です。

2. 整列コンタクトで挿抜がスムーズ。

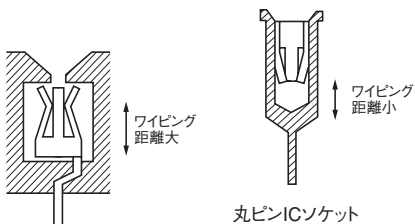
接触状態の比較

ミューICソケット	
丸ピンICソケット	

すべてのコンタクトがICリードと面接触するように整列しているため、挿抜力が小さくスムーズです。

また、インナーコンタクトがないため、IC挿入時の引っかかりもありません。

3. 新発想チュールリップ型ミューコンタクトにより、接点ワイピング効果大。



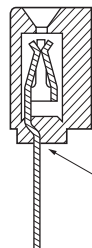
ミューICソケット

丸ピンICソケット

4. 当社独自の封孔処理により、優れた耐腐蝕性を実現。

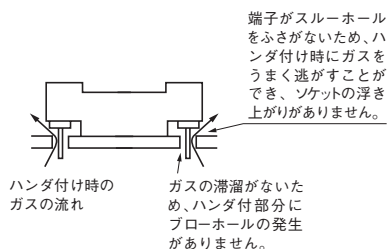
コンタクト表面には封孔処理を施し、薄い金めっき処理でも厚い金めっき処理と同等の接触信頼性と耐腐蝕性を実現しています。

5. 同時成形端子構造でフラックスタイト。



金属部品と樹脂部を同時成形し、フラックスの這い上がりを防止。

6. はんだ付け時の浮き、はんだのブローホールの発生を防止。



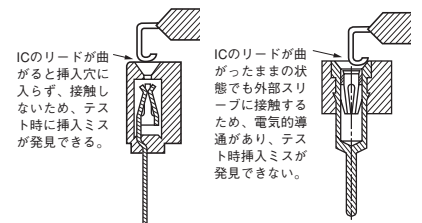
ハンダ付け時のガスの流れ

ガスの滞留がないため、ハンダ付け部分にブローホールの発生がありません。

7. ICリードの挿入ミスが容易に発見でき、防止できるフレーム構造。

コンタクトがフレームの中に隠れているため、ICが正確に挿入されないかぎり接触しません。したがって、テストにより、容易に挿入ミスが発見できます。

IC挿入時にリードが曲ってしまった場合

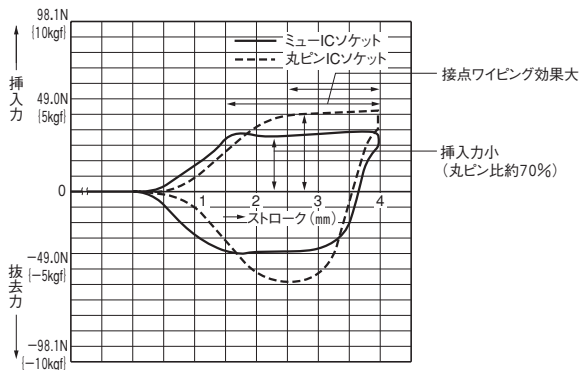


ミューICソケット

丸ピンICソケット

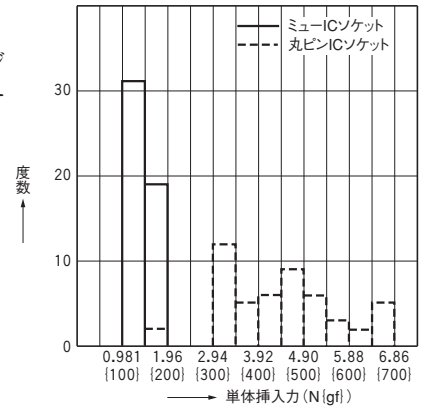
挿抜力が小さく、挿入がスムーズに行えます。

●ミューICソケットと丸ピンICソケットの総合挿抜力の比較。
専用の挿抜試験機により、40ピンのIC挿抜時の挿抜力を測定比較。
従来所定のゲージによりピン単位で最大値を測定していたところを、
IC全体での挿抜力を連続的に測定。



●ミューICソケットと丸ピンICソケットの単体挿入力の比較。
ゲージにより1ピン毎の挿入力を比較。ミューICソケットは、丸ピンICソケットに比べ、挿入力が小さく、かつそのバラツキも小さいことがわかる。

●単体挿入力の分布
試料：50端子
条件：挿入力測定ゲージ
0.60×0.30スチールゲージ



接触面の磨耗が少なく長寿命です。

●ミューICソケットと丸ピンICソケットの100回挿抜後の接触面の比較。
挿抜条件：ICの挿入にはインサータを使用

	接触面の拡大写真 (200倍)	接触面のAuめっき分布状態 (X線マイクロアナライザによる表面分析 白く写った部分がAu部分)
ミューICソケット		
丸ピンICソケット		
説明	ミューICソケットは、 面接触のため 接触面積が大きく、 摩耗が少ないが、 丸ピンICソケットは、 ICリードとの接触面積が小さく、深く削れている。	ミューICソケットは、ほとんどAuが残っているが、 丸ピンICソケットは、接触部分には、 Auが残っていない。



■品番体系

AXS 2 0 [] [] [] 1 K

20：ミューICソケット

《芯数(2桁表示)》

06：6芯 08：8芯 14：14芯 16：16芯
18：18芯 20：20芯 24：24芯 28：28芯
32：32芯 40：40芯

《端子配列・端子形状》

1：DIL端子配列・はんだディップ端子
7：DIL端子配列・はんだディップ端子
(24芯：列間ピッチ7.62mm)

《めっき仕様(接触部/端子部)》

1：Auめっき/Snめっき

■品種

端子部		Snめっき	箱入数	
接触部		Auめっき		
タイプ	芯数	ご注文品番	内箱 (スティック)	外箱
DIL	6	AXS200611K	50個	300個
	8	AXS200811K	50個	300個
	14	AXS201411K	25個	300個
	16	AXS201611K	25個	300個
	18	AXS201811K	20個	300個
	20	AXS202011K	20個	300個
	24 *1	AXS202411K	15個	300個
	24 *2	AXS202471K	15個	300個
	28	AXS202811K	15個	300個
	32	AXS203211K	10個	300個
	40	AXS204011K	10個	300個

*1は列間ピッチ15.24mm

*2は列間ピッチ7.62mm

注) 全品種スティック包装です。

■定格

1. 性能概要

項目	性能	条件	
電気的特性	定格電流	1A	
	耐電圧	AC1,000V 1分間	検知レベル1mAにて
	絶縁抵抗	1,000MΩ以上	DC500Vメガーにて
	接触抵抗	20mΩ以下	JIS C 5402の測定方法に基き、HP4338Bで測定する
	静電容量	2pF以下	1KHzにて
機械的特性	耐振性	147m/s ² 15Gまたは全振幅1.52mmの小さい方/10Hz~2,000Hz	試験中最大100mA通電し1μsec.以上の電流遮断がないこと
	耐衝撃性	981m/s ² 100G	試験中最大100mA通電し1μsec.以上の電流遮断がないこと
	単体挿入力	2.70N 275gf以下	表面粗さ0.1S以下の0.60×0.30スチールゲージにて測定する
	単体抜去力	0.392N 40gf以上	表面粗さ0.1S以下の0.40×0.20スチールゲージにて測定する
	端子保持力	14.7N 1.5kgf以上	
	抜挿寿命	1,000回以上	0.50×0.25スチールゲージにて
適合リード	0.38~0.61×0.20~0.35mm		
耐環境性	硫化水素	テスト後 接触抵抗20mΩ以下	湿度75~80%RH、温度40℃±2℃、濃度3ppm±1ppmに240時間放置後
	二酸化イオウ	テスト後 接触抵抗20mΩ以下	湿度90~95%RH、温度40℃±2℃、濃度10ppm±3ppmに96時間放置後
	耐湿度性	テスト後 接触抵抗20mΩ以下 絶縁抵抗300MΩ以上	湿度90~95%RH、温度40℃±2℃、240時間放置後
	熱衝撃性	テスト後 接触抵抗20mΩ以下 絶縁抵抗300MΩ以上	-55℃(30分)→+125℃(30分)を1サイクルとし、5サイクル実施後
	使用周囲温度	-55℃~+125℃ (ただし、低温においては水結しないこと)	
	はんだ耐熱	260℃ 5秒以内 はんだ槽 300℃ 2秒以内 はんだごて	

2. 材質・表面処理

部品名	材質	表面処理
フレーム	ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)	-
コンタクト	銅合金	接触部; Ni下地Auめっき、端子部; Ni下地Snめっき

■寸法図(単位mm)

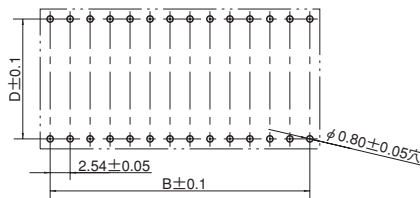
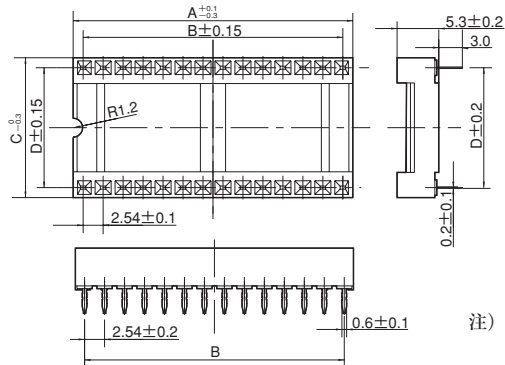
●CADデータ マークの商品は制御機器Webサイト (<http://panasonic-denko.co.jp/ac/>) よりCADデータのダウンロードができます。

●DILはんだディップタイプ

●CADデータ 外形寸法図

プリント基板加工寸法図(BOTTOM VIEW)

寸法表 (mm)



芯数	A	B	C	D
6	7.62	5.08	10.16	7.62
8	10.16	7.62	10.16	7.62
14	17.78	15.24	10.16	7.62
16	20.32	17.78	10.16	7.62
18	22.86	20.32	10.16	7.62
20	25.4	22.86	10.16	7.62
24*1	30.48	27.94	17.78	15.24
24*2	30.48	27.94	10.16	7.62
28	35.56	33.02	17.78	15.24
32	40.64	38.1	17.78	15.24
40	50.8	48.26	17.78	15.24

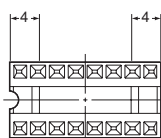
注) リブ:6, 8, 14, 16芯はなし、18, 20, 24, 28芯は1本32, 40芯は2本付いています。詳しくはリブ位置寸法図をご覧ください。

*1は列間ピッチ15.24mm
*2は列間ピッチ7.62mm

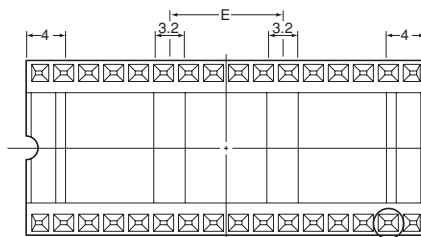
一般公差±0.3

●リブ位置寸法(DILタイプ)

6芯~16芯



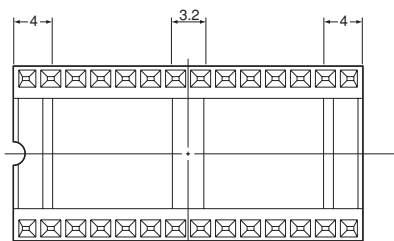
32芯~40芯



寸法表(mm)

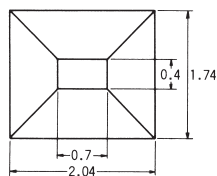
芯数	E
32	11.5
40	15.5

18芯~28芯



一般公差±0.3

●ICリード挿入口寸法



注) ICリード挿入口寸法以上のリードを挿入しないでください。適合リード寸法は、0.38~0.61×0.20~0.35mm

■使用上のご注意

1. ミューICソケットでは、IC端子ガイド□形状を角形の樹脂製として、コンタクトに過大な変位を与えない構造としています。そのためIC挿入時の端子曲げ角度の矯正においては、丸ピンタイプよりも矯正角度を大きくし、ミューICソケットのIC端子挿入口内に全端子が入るよう、矯正後ICを挿入ください。スムーズな挿入ができます。

特にICの端子先端が平で誘い込みの無い場合には十分にお気をつけください。

2. 適合リード寸法は参考までに0.38~0.61×0.20~0.35となります。適合寸法以上のリードを挿入しないようにしてください。コンタクトを変形させるおそれがあります。

3. ディップはんだ槽でのはんだ付けは、温度260℃以下、時間5秒以内で実施してください。はんだごてでののはんだ付けは、こて先温度300℃以下、時間2秒以内で実施してください。

また、端子には力が加わらないようにはんだ付ください。

4. フラックスは非腐蝕性のロジン系をご使用ください。

5. フラックスの溶剤は化学作用の少ないアルコール系をご使用ください。

6. フラックスがICソケットの上面から入らないようにご注意ください。

7. ICの取り付け、取りはずしには、IC挿入、引き抜き工具をご使用ください。

推奨挿入工具: 常盤商工製IT41シリーズ
オーケー・インダストリー
ス製MOSシリーズ

8. 端子部を折り曲げますと同時成形部を破損しはんだ付時にフラックスが這い上がる恐れがありますのでご注意ください。

機器設計時におかれましては、最新の商品仕様書にてご確認願います。

このPDFカタログデータに記載の内容は平成20年10月現在のものです。